

	A室(3F MOホール)	B室(2F 会議室2)	C室(2F 会議室3)	D室(1F 会議室1)
9:00	登録受付(1F エントランスホール)			
9:15	<p>【2A1】低溫鉛フリーはんだ 座長: 大塚 正久(芝浦工業大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 低溫鉛フリーはんだ実装技術開発プロジェクト 菅沼亮昭(大阪大学)、牧本次生(日立製作所)、須賀健也(東京大学)、津久井勲(東海大学) Sn₈₂Zn₁₈Bi 無鉛クリームはんだの連続印刷性の改善と信頼性 秋尾浩一(二ホンゲンマ) 低融点無鉛はんだ(Sn₈₂Zn₁₈Bi)の接合信頼性確認と量産導入 高橋 亨(ソニー) Sn-Zn系鉛フリーはんだの接合信頼性 北山雅之、庄野忠昭(富士通)、山崎一寿、野口道子(富士通研究所) 	<p>【2B1】高周波電気設計 座長: 江間 富世(松下通信工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> GHz用電源としての伝送線路設計の検討 山口達夫、秋山 豊、日下紀之、大塚寛治(明星大学) 低周波時定セラミックスを用いたHVIC向け平面回路の開発 荻原政男、高田芳文、松本 隆、山田隆之(日立製作所) 近接配置と高周波放射について 井上博文、古谷 充、塚 淳(日本電気) 2000pin超大型FC-BGA/パッケージの高密度実装及び給電系電気設計 中川和之、渡辺田樹、馬場治治、木村通孝、山岸圭太郎、佐々木雄一、生田目雅章(三菱電機) 	<p>【2C1】ウェットプロセス ビアフィリング 座長: 近藤 和夫(岡山大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> スルファミン酸ニッケルによるビアフィリング 伴 和恵、金子紀男、若林信一、中沢昌夫、田中秀一、酒井豊明(新光電気工業) ビアフィルめっきの実装評価 須藤俊英、大平哲郎、倉持敏一、山口明彦、小川義明(三菱電機) ビアホール内銅めっき充てんテープによるF-BGAのはんだボール接合信頼性向上 松浦 亮、珍田 聡、柴田明司(日立電線) 下面電極型電子部品用銅めっき充填テープ基材 珍田 聡、松浦 亮、西村英人、吉和崇之(日立電線) 	<p>【2D1】信頼性評価・解析技術 座長: 須藤 俊夫(東芝)</p> <ol style="list-style-type: none"> 微小回路におけるマイグレーション発生メカニズムの検討 河野大太、義隆 松本 徹、吉澤 潤(日本シイエムケイ) プリント配線板の各種回路減プロセスとイオンマイグレーションの関係 糸川和博、佐藤 誠、高橋久弥、吉原佐雄、白根高史(宇都宮大学)、馬庭 亮(NEC山崎) HASTによるプリント配線板の耐湿性評価について 中塚裕治(新光電気工業)、津久井勲(東海大学) 薄層窒素における耐リフロー性の問題 川野恒一郎(友友スリーエム)
10:35	<p>【2A2】低溫鉛フリーはんだ 座長: 新井 進(信州大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> Znはんだによるチップ部品の外観劣化実装 吉田 陽、中島隆志、松原浩司、横尾隆二(シャープ) Sn-Zn-Biはんだを用いたCSP実装における継手特性 北原隆志、若西宏昭、廣瀬雅夫、小林麻二郎(大阪大学)、山口敦史、古澤 勇、大谷博之(松下電器産業)、池田倫台(電気通信大学) Sn-Zn-Bi系鉛フリーはんだとCu電極との界面反応現象の解明 柳川博人、今村武史、井出英一、廣瀬雅夫、小林麻二郎(大阪大学) Sn-Zn系Pbフリーはんだのフロー接合信頼性 杉浦正洋(ソルダークート)、田辺一彦(NECインフロンティア)、寺田博昭(富士日本電気)、武田登志夫(日本電産)、田中 俊(荊川化学工業)、水谷哲治(マルヤ製作所) Sn-Zn系フローはんだだけの特性 忠内二弘、小松 出、松本一高、今村裕子、鈴木 功(東芝) 	<p>【2B2】SIP(システムインパッケージ) 座長: 西田秀行(イタカホリデバイス)</p> <ol style="list-style-type: none"> 高周波アナログ回路チップ搭載 SIP(System in Package)の電気特性シミュレーションによる開発効率化の検討 小澤 要、高島 晃、小西井一成、平野哲也(富士通) 薄型フィンピッチCOCを達成する無電解めっき ハンブによるはんだNCP接合 森 俊裕、渡辺明彦、山内 朗(東レエンジニアリング)、畑田賢造(アトムニクス研究所) ハンブ内蔵基板を用いたシステムインパッケージ技術の開発 中村英博、榎本哲也、廣木孝典、中野昭士(日立化成工業) キャピタを内蔵したパッケージの開発 大井 淳、山崎隆志、六川昭雄、飯島隆廣、若林信一(新光電気工業) シリコンを利用した高線径小型化技術 松下浩二、武居正彦、大野勝史(富士電機) 	<p>【2C2】ウェットプロセス ハンブ形成 座長: 綿舟 秀美(甲南大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 亜硫酸浴からの電圧/流速電解によるAu-Sn合金めっき 栗津亮二、篠原直行、新井 進、金子紀男(信州大学)、倉科 匡(大和電機工業) ハリス電解によるCu合金めっき皮膜の作製 志水信裕、篠原直行、新井 進、金子紀男(信州大学)、若林信一(新光電気工業) 高アスペクト比ハンブの作製 前田享平、近藤和夫(岡山大学) 微小電極上への無電解めっき方式によるNAUハンブ、LEBMの実用化 畑田賢造(アトムニクス研究所)、江守善雄、渡三生(志賀野メッキ) ディップ方式による低融点金属のハンブ形成と微小接合技術の開発 畑田賢造(アトムニクス研究所)、江守善雄、渡三生(志賀野メッキ) 	<p>【2D2】信頼性評価・解析技術 座長: 于 強(横浜国立大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> PbフリーはんだBGA接合部の信頼性評価技術 矢口昭弘、山田宗博、山本健一(日立製作所) FC-BGAにおけるハンブ接合部の信頼性評価 上野一也、十河英彦、猪口憲一、林富美男(コベルコ科研) 実装はんだ接合部の落下衝撃強度評価および試験装置の開発 菊也信、于 強、渡邊啓治、白鳥正樹(横浜国立大学) 有限要素解析によるアンダーフィル充填部のチップ表面腐食解析 内田正貴、今村和之、森岡宗弘、南澤正榮(富士通) 樹脂製インターポーザーを使用したマルチチップモジュールの構造信頼性向上 中 康弘、田中直敬、内藤孝洋(日立製作所)
12:20	昼 休 み			
13:20	<p>【2A3】鉛フリーはんだ 座長: 細田 直工(東京大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> ランド剥離に関する考察 田辺一彦(NECインフロンティア) Sn-Ag-Cu-Sn-Zn-Bi 2層無鉛鉛フリー-CSPの加速係数に関する検討 渡辺田樹、横田康夫(松下電器産業) 超音波を用いた鉛フリーはんだの新しいはんだ付け方法 籠原大助、石田謙司、堀内俊孝、松重和美(京都大学)、菊也信美(滋賀県立大学)、末次慶一郎、猪狩貴史(松下電器産業)、日比野俊治(松下FAエンジニアリング) 鉛フリーはんだによる一括多層・微細層間接合技術 岡田亮一、青木 仁、原 英真、湯浅 茂、伊藤真一郎(友友ベークライト) 	<p>【2B3】実装プロセス 座長: 江森 雄二(沖電気工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pbフリー化に伴うワイヤボンディングステッチ接合問題の解決 板橋光、安原和彦、星雅史(田中電子工業) ACF実装時の粒子、気泡の挙動分析 山内 朗、中林利之(東レエンジニアリング) 液状プリフォーム樹脂を用いたフラックスレスフリップチップ接合・封じ技術 畑中康道、多田和明、岡 誠次(三菱電機) Auハンブ及び封接用樹脂封じチップを用いたフリップチップ実装技術 宮崎崇志、吉野研次、方慶一郎(日本電気) 微小めっきスプリングを用いた低力フリップチップ接合技術の開発 曾川和道、山崎隆志、村上 一、北城 栄(日本電気) 	<p>【2C3】ウェットプロセス 化学処理無電解めっき 座長: 吉原 佐雄(宇都宮大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> 研磨/酸化/水素系エッチング液による銅の溶解挙動 高井健次(日立化成工業)、松本克夫、谷口尚司(東北大) 環境配慮した電子部品の洗浄技術 竹ノ内敏一、田中 博(新光電気工業) TO₂量子効果素子駆動力とする新規無電解めっきプロセスの開発 松原昌弘、池田慎吾、赤松謙祐、綿舟秀美(甲南大学) 液晶ポリマーへの無電解めっき 梅原昌次、佐藤 正、小早川誠一(神奈川大学) ノーシアン合金めっき液の開発 今藤 桂、阿部美和、中澤昌夫、若林信一、金子紀男(新光電気工業) 	<p>【2D3】信頼性評価・解析技術 座長: 齊藤 雅之(東芝)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3次元デバイス創成のためのレーザ貫通電極加工における熱伝導解析 安田真大、藤本公三、安田清和(大阪大学) 非均質超音波洗浄法の実装 -電子部品への適用- 竹内 健、川上直哉、宮田 徹(日立建機ファインテック)、山本 弘(日立建機) 高密度リードフレームのための打ち抜き加工シミュレーション 北島正邦、赤坂貞典、若林信一(新光電気工業)、小杉 俊、工藤 誠(長野県工業技術センター) 狭ピッチ多ピンコンタクト対応膜厚プロファイルの開発 長谷川健彦、成塚康則、数下 明、森 照享、春日部 進、長谷部昭男(日立製作所) 損失要因の解析と導体表面粗さの効果検討 鈴木 徹、荻原政男、高田芳文、松本 隆(日立製作所)、千石剛夫(日立プリント基板ソリューション)
15:00	<p>【2A4】光インタコネクション 座長: 小池 真司(日本電信電話)</p> <ol style="list-style-type: none"> 光ファイバ配線を用いた光バックプレーンの検討 市村 顕、小西敬文、茨木 修(超先端電子技術開発機構) フォトリーチングポリマ材料を用いた光導波路形状形成技術の検討 堀 彰弘(超先端電子技術開発機構)、野崎剛保(日立電線) 自己形成導波路による光簡易接続技術 広瀬直宏、茨木 修(超先端電子技術開発機構) アクティブインタポザー(AIP)構造の提案と基本評価モデルの検討 平松星紀、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、石塚 剛、岡田雅真、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) アクティブインタポザー(AIP)用光素子および基本評価モデルの検討 石塚 剛、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、岡田雅真、平松星紀、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 送受アクティブインタポザー(AIP)モデルの光伝送評価 岡田雅真、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、石塚 剛、平松星紀、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 	<p>【2B4】微細配線形成 座長: 馬場 和宏(日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> 転写用ビームラブリテラ 峯 洋二、高島 洋、矢野健太郎(日立金属) 光化学反応を利用したポリイミド樹脂への選択的回路形成技術 泉田信也(東レエンジニアリング) セミアディティブ法による微細化とビアフィリングの同時形成技術 吉野 裕、山田 学、黄 弘、清水谷千尋(日本シイエムケイ) 受動部品内蔵BGA配線板 今村謙弘、平井浩之、山口雄二、島田 修、藤原和広(ディーティーサーキットテクノロジー) 	<p>【2C4】ウェットプロセス はんだ接合に対応するめっき技術 座長: 橋本 薫(富士通研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> 界面構造制御による電析 Sn 皮膜からのウイスキー発生抑制 田村 康、原 太樹、内田 衛(石原薬品)、綿舟秀美(甲南大学) 鉛フリーはんだ接合に対応した硫酸浴からのSn-Ag合金めっき 白灰優典、金子紀男、新井 進、篠原直行(信州大学)、若林信一(新光電気工業) 無電解Ni/Puめっき膜の置換金属層の構造について 高橋久弥(日本電気)、伊藤昌伸(大阪市立工業研究所)、吉原佐雄(宇都宮大学) 無電解Ni-Pu置換Auめっきのはんだ付け性について 小川 誠、高岡英真、浜田邦彦、坂部隆雄(村田製作所) 無電解Ni/Au処理基板へのSn-ZnおよびSn-Zn-BiはんだのBGA接合性 杉浦 敬、中尾弘弘、福田 豊(メルテックス)、木村隆(物質・材料研究機構)、渡辺 徹(東京理科大学) 	<p>【2D4】設計 座長: 福岡 義孝(ウェイスティー)</p> <ol style="list-style-type: none"> 高速回路基板における電線径の低減手法の検討 中野智博、佐々木伸一(佐賀大学) 高速信号線におけるクロストークの低減手法 渡邊 亮、佐々木伸一(佐賀大学) 電子素子近傍のシールド導体面による放射ノイズ低減効果のシミュレーション 菊也信美、芳賀 和、茨木 修、星野茂樹(超先端電子技術開発機構) ビルドアップ配線板高密度化対応への低コストリソノーム製造技術 西田直樹(日本アイ・ピー・エム)
16:45	<p>【2A4】光インタコネクション 座長: 小池 真司(日本電信電話)</p> <ol style="list-style-type: none"> 光ファイバ配線を用いた光バックプレーンの検討 市村 顕、小西敬文、茨木 修(超先端電子技術開発機構) フォトリーチングポリマ材料を用いた光導波路形状形成技術の検討 堀 彰弘(超先端電子技術開発機構)、野崎剛保(日立電線) 自己形成導波路による光簡易接続技術 広瀬直宏、茨木 修(超先端電子技術開発機構) アクティブインタポザー(AIP)構造の提案と基本評価モデルの検討 平松星紀、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、石塚 剛、岡田雅真、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) アクティブインタポザー(AIP)用光素子および基本評価モデルの検討 石塚 剛、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、岡田雅真、平松星紀、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 送受アクティブインタポザー(AIP)モデルの光伝送評価 岡田雅真、三川 孝、比留間建之、木下雅夫、石塚 剛、平松星紀、熊井晃一、古山英人、松井輝二、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 	<p>【2B4】微細配線形成 座長: 馬場 和宏(日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> 転写用ビームラブリテラ 峯 洋二、高島 洋、矢野健太郎(日立金属) 光化学反応を利用したポリイミド樹脂への選択的回路形成技術 泉田信也(東レエンジニアリング) セミアディティブ法による微細化とビアフィリングの同時形成技術 吉野 裕、山田 学、黄 弘、清水谷千尋(日本シイエムケイ) 受動部品内蔵BGA配線板 今村謙弘、平井浩之、山口雄二、島田 修、藤原和広(ディーティーサーキットテクノロジー) 	<p>【2C4】ウェットプロセス はんだ接合に対応するめっき技術 座長: 橋本 薫(富士通研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> 界面構造制御による電析 Sn 皮膜からのウイスキー発生抑制 田村 康、原 太樹、内田 衛(石原薬品)、綿舟秀美(甲南大学) 鉛フリーはんだ接合に対応した硫酸浴からのSn-Ag合金めっき 白灰優典、金子紀男、新井 進、篠原直行(信州大学)、若林信一(新光電気工業) 無電解Ni/Puめっき膜の置換金属層の構造について 高橋久弥(日本電気)、伊藤昌伸(大阪市立工業研究所)、吉原佐雄(宇都宮大学) 無電解Ni-Pu置換Auめっきのはんだ付け性について 小川 誠、高岡英真、浜田邦彦、坂部隆雄(村田製作所) 無電解Ni/Au処理基板へのSn-ZnおよびSn-Zn-BiはんだのBGA接合性 杉浦 敬、中尾弘弘、福田 豊(メルテックス)、木村隆(物質・材料研究機構)、渡辺 徹(東京理科大学) 	<p>【2D4】設計 座長: 福岡 義孝(ウェイスティー)</p> <ol style="list-style-type: none"> 高速回路基板における電線径の低減手法の検討 中野智博、佐々木伸一(佐賀大学) 高速信号線におけるクロストークの低減手法 渡邊 亮、佐々木伸一(佐賀大学) 電子素子近傍のシールド導体面による放射ノイズ低減効果のシミュレーション 菊也信美、芳賀 和、茨木 修、星野茂樹(超先端電子技術開発機構) ビルドアップ配線板高密度化対応への低コストリソノーム製造技術 西田直樹(日本アイ・ピー・エム)